



美光科技出样业界首款搭载 LPDDR5 的 uMCP 封装产品， 为 5G 智能手机提供更强性能和电池续航

该款多芯片封装产品集成低功耗 DRAM、NAND 及板载控制器，使芯片尺寸缩小了 40%

中国上海，2020 年 3 月 11 日——内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU) 今日宣布，开始出样业界首款同时搭载低功耗 DDR5 (LPDDR5) DRAM 的通用闪存 (UFS) 多芯片封装 (uMCP) 产品。这款 uMCP 产品为纤薄紧凑的中端智能手机设计提供了高密度、低功耗的存储解决方案。

美光的新款 uMCP5 封装采用了公司在多芯片封装方面的创新和前沿技术，集成了低功耗 DRAM、NAND 和板载控制器，其与双芯片解决方案相比，占用空间减少 40%。这种优化的架构可降低功耗，缩小内存芯片尺寸，支持更小、更灵活的智能手机设计。

美光移动产品事业部高级副总裁兼总经理 Raj Talluri 博士表示：“这款业内首创的 uMCP5 封装解决方案衔接了新款 LPDRAM 和 UFS，使内存和存储带宽提高 50%，同时带来更低功耗。该款产品使中端 5G 智能手机能够在超低延迟响应时间和低功耗模式下运行，从而可以支持旗舰智能手机所具备的各种功能，如搭载多枚高分辨率摄像头、多人游戏和 AR / VR 应用。”

美光 uMCP5 采用先进的 1y 纳米 DRAM 制程技术和全球最小尺寸的 512Gb 96层 3D NAND 裸片。297 引脚球栅阵列 (BGA) 封装支持双通道 LPDDR5，速度高达 6,400Mbps，性能比上一代接口提升了 50%。这款新型封装还为当今市场上的 uMCP5 提供了最高的存储和内存密度，分别为 256GB 和 12GB。

uMCP5 为美光 LPDDR5 DRAM 提供了理想的解决方案。5G 网络将于 2020 年开始在全球进行大规模部署，而美光下一代 LPDDR5 内存可满足其对更高内存性能和更低能耗的需求，同时让 5G 智能手机能以高达 6.4Gbps 的速度处理数据，在解决数据处理瓶颈问题方面会起到至关重要的作用。

美光的 LPDDR5 uMCP5 封装现已能立即出样给特定的合作伙伴。



关于 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司)

美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商。凭借旗下全球性品牌 Micron® (美光) 和 Crucial® (英睿达), 美光丰富的高性能内存和存储技术组合——包括 DRAM、NAND、3D XPoint™及 NOR, 通过改变世界使用信息的方式来丰富生活。凭借逾 40 年的技术领军地位, 美光的内存及存储解决方案帮助移动端、数据中心、客户端、消费端、工业、图形、汽车、网络等重要市场实现了颠覆性发展趋势, 包括人工智能、5G、机器学习和自动驾驶。美光科技的普通股在纳斯达克上市交易, 股票代码是 MU。如需了解 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司) 的更多信息, 请访问 www.micron.com。

© 2020 Micron 及 Micron 徽标及其他 Micron 商标均为 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司) 所有。所有其他商标分别为其各自所有者所有。

请关注我们, 加入美光科技社交平台, 一起交流关于存储和创新的话题:

- 博客: <https://www.micron.com/about/blog>
- 领英: <https://www.linkedin.com/company/micron-technology/>

微博:



微信:



美光媒体关系联系人:

美光科技股份有限公司
Erica Pompen
电话: +1 (408) 834-1873
E-mail: epompen@micron.com

美光科技股份有限公司
冯昊 先生
电话: +86 21 6103 3311
E-mail: ralphfeng@micron.com

万博宣伟公关



张圳 先生

电话: +86 010 8569 9909

E-mail: jzhang2@webershandwick.com

美光投资者关系联系人:

美光科技股份有限公司

Farhan Ahmad

电话: +1 (408) 834-1927

E-mail: farhanahmad@micron.com